

# Industrieller Box-PC

## BPC3200-N\*



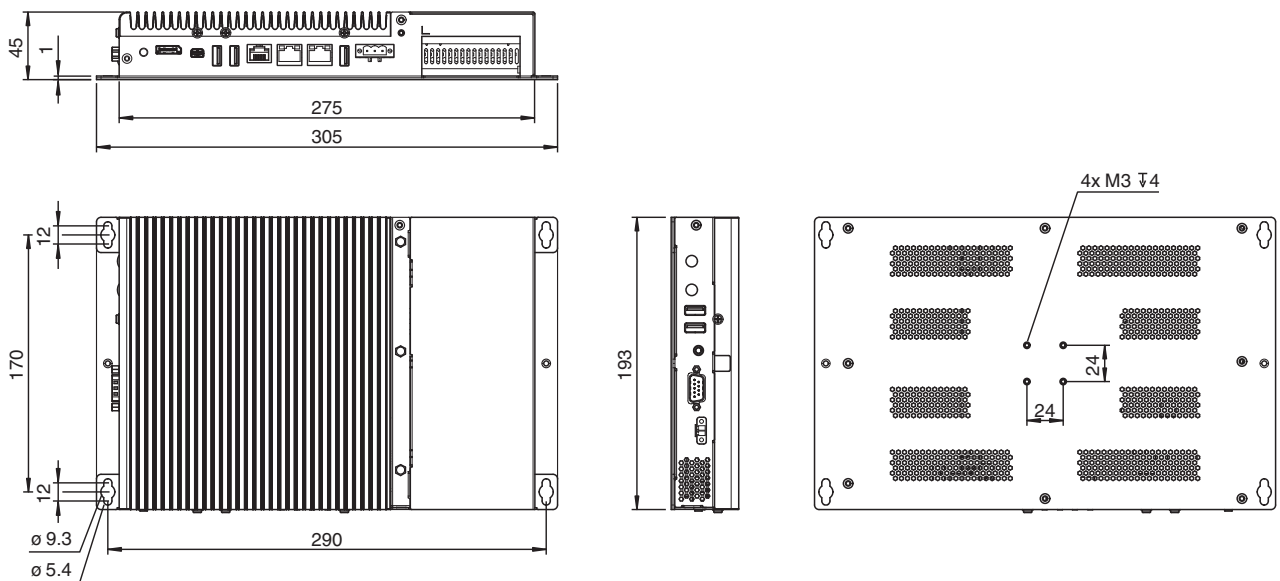
- Intel Celeron der 7. Generation und i5 eingebettete Prozessor-Generation
- Unterstützt hochleistungsfähigen M.2 NVMe-Speicher
- Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C
- Installationsflexibilität: Stand-Alone-PC, Panel-PC, System mit Gehäuse
- Integrierte eigensichere USB-Ports für Tastaturanschlüsse

### Industrieller Box-PC

## Funktion

Die Box PC 3200-Serie basiert auf der 7. Generation von Intel® Celeron und i5 (Kaby Lake) Embedded-Prozessoren und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie unterstützt die neueste Hochgeschwindigkeits-Speichertechnologie (M.2 NVMe 1.3) und erweiterte RAM-Konfigurationen mit bis zu 16 GB DDR4. Das Gerät bietet eine große Anwendungsflexibilität und kann als Standalone-Gerät, als Panel-PC (bei Montage auf einer Pepperl+Fuchs-Displayeinheit) oder als HMI-System (Panel-PC in einem Pepperl+Fuchs-Gehäuse) verwendet werden.

## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Typ Industrieller Box-PC

### Hardware

Prozessor Intel® Core™ i5-7300U  
Intel® Celeron™ 3965U

**Technische Daten**

RAM	<p>2x SO-DIMM-Steckplätze, unterstützt bis zu 32 GB DDR4-2133 (ein SO-DIMM-Steckplatz)</p> <p><b>Konfigurierbare RAM-Optionen:</b>                  Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A):                  A: 1x 4GB DDR4-2133 [Celeron]                  B: 1x 8GB DDR4-2133                  C: 1x 16GB DDR4-2133</p> <p>Erweiterter Temperaturbereich (Temperaturoption B):                  K: 1x 4GB DDR4-2133 [Celeron]                  L: 1x 8GB DDR4-2133                  M: 1x 16GB DDR4-2133</p>
Massenspeicher	<p><b>Speicherschnittstelle:</b>                  1x M.2 2242/2280 M Key, PCIe + SATA 3                  1x M.2 2242/2280 M Key, 2242/2280, SATA 3, unterstützt Raid 0/1 [i5]</p> <p><b>Konfigurierbare Speicheroptionen:</b>                  Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A):                  A: 32 GB M.2 SATA 3 [Celeron]                  D: 256 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x)                  E: 512 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x)</p> <p>Erweiterter Temperaturbereich (Temperaturoption B):                  K: 32 GB M.2 SATA 3 [Celeron]                  P: 256 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x)                  Q: 512 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x)</p>
<b>Versorgung</b>	
Eingangsstrom	max. 3 A, max. 60 W
Leistungsaufnahme	
DC	24 V d. c. (20 ... 28 V d. c.) (SELV/PELV or NEC class 2)
<b>Schnittstelle</b>	
Schnittstellentyp	<p>Rückseite:                  1x Netzschalter mit LED-Anzeige                  1x DisplayPort 1.2-Anschluss (unterstützt DP++)                  1x Mini DisplayPort 1.2 Port (unterstützt DP++)                  2x USB Ex i Ports vorbereitet für Pepperl+Fuchs eigensichere Tastatur                  1x RS232/422/485 Port (1x RJ45)                  2x RJ45 Ports für Gigabit Ethernet (Intel I219 / I210)                  1x USB 2.0 Port                  1x Stromeingang mit 3-poliger Klemmleiste</p> <p>Linke Seite:                  2x Antennenlöcher                  2x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse                  1x 3,5-mm-Audiobuchse (Line-out)                  1x RS232/422/485-Anschluss (D-SUB 9)                  1x Anschluss für externe Power-Taste</p> <p>Interne Erweiterungsoptionen:                  1x PCIe 4x Steckplatz für Low-Profile-Karten                  1x Mini-PCI-Express-Sockel in Standardgröße / M.2 2230 E Schlüsselbuchse</p>
<b>Richtlinienkonformität</b>	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 61326-1:2013 (ind. Locations) EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55011:2016+A1:2017
Explosionsschutz	
Richtlinie 2014/34/EU	EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	EN IEC 63000:2018
<b>Software</b>	
Betriebssystem	<p>Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64)                  VisuNet RM Shell 5 (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64)) [Celeron, 4 GB RAM, 32 GB Speicher]</p> <p><b>Optional:</b>                  T: ACP ThinManager Ready BIOS (Celeron, 4 GB RAM, kein Speicherplatz)</p>
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	<p>Temperaturklassen:                  A: 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)                  B: -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) [mit erweitertem Temperatur-RAM/Speicher]</p>

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-17 Ausgabedatum: 2023-01-17 Dateiname: t195086\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com




Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com



**Technische Daten**

Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Schockfestigkeit	Beschleunigung: 15 g Dauer: 11 ms Schocks: 18 (3 pro Achse pro Richtung)
Vibrationsfestigkeit	Amplitude/Beschleunigung: +/- 0,075 mm // 1 g Frequenzbereich: 10Hz - 150 Hz Sweeps: 20
<b>Mechanische Daten</b>	
Schutzart	IP 20
Material	Lackiertes Blech und stranggepresstes Aluminium
Masse	ca. 2,5 kg
Abmessungen	305 mm x 193 mm x 45 mm
Befestigung	Wandmontage, DIN-Schiene (über optionalen Adapter)
<b>Internationale Zulassungen</b>	
UL-Zulassung	
Zugelassen für	<b>UL OrdLoc</b> UL approval E223772 UL61010-1 Ed.3 UL 61010-2-201 Ed2 CAN/CSA C22.2 No 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No 61010-2-201  <b>UL HazLoc</b> UL approval E492874  IS circuits for CL I, DIV 2, GP A-D CL II, DIV 2, GP E, F, G CL III IS circuits for CL I, ZN 2, IIC CL II, ZN 22, IIIB CL III, ZN 22, IIIA Install per drawing 116-0478  Mounting in CL I, DIV 2, GP A-D, T4 CL II, DIV 2, GP E, F, G CL III Mounting in CL I, ZN 2, IIC, T4 CL II, ZN 22, IIIB CL III, ZN 22, IIIA
ATEX-Zulassung	
ATEX-Zertifikat	UL 22 ATEX 2478X
ATEX-Kennzeichnung	II 3 G Ex ec [ic Gc] IIC T4 Gc
IECEx-Zulassung	
IECEx-Zertifikat	IECEx ULD 22.0016X
IECEx-Kennzeichnung	Ex ec [ic Gc] IIC T4 Gc
IECEx-Standard	IEC 60079-0:2017 Ed 7.0 IEC 60079-7:2017 Ed 5.1 IEC 60079-11:2011 Ed 6.0

**Zubehör**

	<b>DPU3200-19SC-304A-V1-N0</b>	Display-Einheit
	<b>DPU3200-15FC-304A-V1-N0</b>	Display-Einheit
	<b>DPU3200-22FC-304A-V1-N0</b>	Display-Einheit

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-17 Ausgabedatum: 2023-01-17 Dateiname: t195086\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

**Typenschlüssel**

Modell	Zertifizierung	Temperatur	Spannungsversorgung	Computing Plattform	RAM	Speicher	Betriebssystem & Software	Optionen
<b>Modell</b>								
<b>BPC3200-</b>	Stand-Alone Box PC							
<b>Zertifizierungen</b>								
<b>N</b>	Industriell, non-ex general purpose							
<b>M</b>	ATEX & IECEx Zone 2 und Class I, Div 2							
<b>Temperatur</b>								
<b>A-NNNN-</b>	0 ... 45 °C							
<b>B-NNNN-</b>	-20 ... 55 °C							
<b>Spannungsversorgung</b>								
<b>D-</b>	24 V DC							
<b>Computing Plattform</b>								
<b>1N</b>	Intel Celeron 3965U							
<b>2N</b>	Intel Core i5 -7300U							
<b>RAM</b>								
<b>A</b>	1x 4 GB, Industrietemperaturbereich [nur Temperatur "A", Operating System "2NN-"]							
<b>B</b>	1x 8 GB, Industrietemperaturbereich [nur Temperatur "A"]							
<b>C</b>	1x 16 GB, Industrietemperaturbereich [nur Temperatur "A"]							
<b>K</b>	1x 4 GB, erweiterter Temperaturbereich							
<b>L</b>	1x 8 GB, erweiterter Temperaturbereich							
<b>M</b>	1x 16 GB, erweiterter Temperaturbereich							
<b>Speicher</b>								
<b>A</b>	32 GB, Industrietemperaturbereich, M.2 SATA [nur Temperatur "A", Operating System "2NN-"]							
<b>D</b>	256 GB, Industrietemperaturbereich, M.2 NVMe [nur Temperatur "A"]							
<b>E</b>	512 GB, Industrietemperaturbereich, M.2 NVMe [nur Temperatur "A"]							
<b>K</b>	32 GB, erweiterter Temperaturbereich, M.2 SATA							
<b>P</b>	256 GB, erweiterter Temperaturbereich, M.2 NVMe							
<b>Q</b>	512 GB, erweiterter Temperaturbereich, M.2 NVMe							
<b>N</b>	Keiner (nur in Kombination mit ACP ThinManager Ready BIOS)							
<b>Betriebssystem &amp; Software</b>								
<b>1NN-</b>	Windows® 10 IoT Enterprise x64 LTSC 2019							
<b>2NN-</b>	Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell 5.x (basierend auf Windows® 10 IoT LTSC 2019)							
<b>TNN-</b>	ACP ThinManager Ready BIOS							
<b>Optionen</b>								
<b>NN0</b>	Standard							

**Beispiel: BPC3200-NA-NNNN-D-2NAA1NN-NN0**

<b>Bevorzugte Konfigurationen:</b>		
High-Performance Konfiguration	BPC3200-NB-NNNN-D-2NLP1NN-NN0	Intel i5 -7300U 8 GB DDR4, erweiterter Temperaturbereich 256 GB M.2 NVMe, erweiterter Temperaturbereich Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Thin Client Konfiguration	BPC3200-NA-NNNN-D-1NAA2NN-NN0	Intel Celeron 3965U 4 GB DDR4, Industrietemperaturbereich 32 GB M.2 SATA 3, Industrietemperaturbereich VisuNet RM Shell 5.x (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019)

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-17 Ausgabedatum: 2023-01-17 Dateiname: t195086\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

